

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2024-043

希荻微电子集团股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度

并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“希荻微”或“公司”）全资子公司 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称“香港希荻微”）。
- 2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 6 亿元人民币或等额 6 亿元人民币的美元的担保额度。
- 被担保人未提供反担保。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、2024 年度向银行等金融机构申请授信额度并提供担保基本情况

（一）情况概述

根据公司 2024 年度经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司香港希荻微预计在 2024 年度向银行申请合计不超过 10 亿元人民币或等额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，授信品种包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、抵押贷款、流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、银行保函、国内外贸易融资等综合授信业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司在上述授信额度内为子公司提供连带责任担保，担保额度预计不超过人民币 6 亿元或等额 6 亿元人民币的美元，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，办理相关手续等，并在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

截至公告日，公司尚未签订上述综合授信合同和担保合同。

上述授信及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际授信及担保额度最终以银行等金融机构最后审批的授信及担保额度为准，具体融资及担保金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资及担保期限以实际签署的合同为准。

（二）决策程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，其有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

（一）香港希荻微

公司名称	Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.
成立时间	2013 年 10 月 4 日
董事	TAO HAI（陶海）
股本情况	已发行股份数目为 90,001,300 股普通股（注）
住所	8/F., Gold & Silver Commercial Building, 12-18 Mercer Street, Central, Hong Kong
主营业务及与希荻微主营业务的关系	集成电路模拟芯片的物流、采购和销售等，系希荻微主营业务的组成部分
股权结构	希荻微持股 100%
	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（万元）
资产总额	97,434.04
负债总额	49,318.37
其中，银行贷款	32.61

流动负债总额	49,253.13
资产负债率	50.62%
净资产	48,115.67
营业收入	45,011.93
净利润	-3,407.95
扣除非经常性损益后的净利润	-3,514.69
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项	否

注：（1）因公司此前对香港希荻微的增资 3,000 万美元（详见公司于 2023 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-015）尚未支付完毕全部增资款，香港希荻微尚未办理股本变更登记，香港希荻微目前股本仍登记为 60,001,300 股。

（2）上述香港希荻微财务数据为香港希荻微合并范围数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。公司董事会将本事项提交给股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或其授权人士办理融资和担保手续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等），其有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

四、董事会意见

董事会认为：本次预计的 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度及担保预计符合公司及子公司正常生产经营的需要，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的利益，有利于推动公司整体持续稳健发展，不会损害公司和股东的利益。

综上，董事会同意公司本次《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 6 亿元人民币，全部

为公司对子公司的担保（不含本次的担保，且全部为已批准但尚未使用的担保额度）。上述金额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 32.70%、29.76%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日